

Informazione Regolamentata n. 2358-11-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 26 Febbraio 2026 06:45:32	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : SECO

Utenza - referente : SECON04 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 26 Febbraio 2026 06:45:32

Data/Ora Inizio Diffusione : 26 Febbraio 2026 06:45:32

Oggetto : SECO e Qualcomm presentano soluzioni
Dragonwing per l'Edge AI a embedded world
2026

Testo del comunicato

Vedi allegato

SECO e Qualcomm presentano soluzioni Dragonwing per l'Edge AI a embedded world 2026

Dai moduli COM Express ad alte prestazioni a HMI industriali scalabili e sistemi Edge AI

Arezzo, 26 febbraio 2026 – In occasione di embedded world 2026 (10–12 marzo, Norimberga), SECO S.p.A. ("SECO" o la "Società") mostrerà soluzioni Edge AI basate sulle piattaforme Qualcomm Dragonwing™, dimostrando come il proprio ecosistema hardware, software e Clea abiliti applicazioni sicure, ad alte prestazioni e indipendenti dal cloud.

SOM-COMe-CT6-Dragonwing-IQ-X: ridefinire l'edge computing industriale ad alte prestazioni

Al centro dell'offerta SECO basata su Qualcomm si trova il **SOM-COMe-CT6-Dragonwing-IQ-X**, un modulo COM Express Type 6 ad alte prestazioni basato sulla serie Qualcomm Dragonwing IQ-X, progettato per **abilitare PC industriali, HMI avanzate e automazione mediante AI senza compromessi tra prestazioni, efficienza energetica e complessità di sistema**. Dotato di CPU Qualcomm® Oryon™ a 12 o 8 core con prestazioni single-thread fino a 3,4 GHz e fino a 45 TOPS di accelerazione AI on-device, supporta controllo in tempo reale, analytics e visualizzazione a alta risoluzione con basso consumo energetico, consentendo design compatti e fanless. Ottimizzato per applicazioni a elevata intensità di elaborazione visiva, supporta più telecamere, doppi ISP, display fino a 2× 5K o 4× 4K e I/O ad alta velocità inclusi USB4, PCIe e UFS 4.0 per una rapida integrazione di sistema. Progettato per ambienti industriali gravosi, il modulo opera da -40°C a +85°C, supporta Windows II IoT Enterprise LTSC e soddisfa i requisiti di lifecycle industriale a lungo termine. Combinato con i BSP SECO, i servizi di integrazione e il **framework software Clea**, fornisce una base scalabile per l'automazione industriale e piattaforme HMI avanzate.

SECO conferma inoltre l'espansione della propria roadmap sulla serie Qualcomm Dragonwing IQ con lo sviluppo di soluzioni SMARC basate su Qualcomm Dragonwing IQ8 e piattaforme COM-HPC Mini basate su Qualcomm Dragonwing IQ9. Queste soluzioni ottimizzate per l'AI sono progettate per supportare applicazioni avanzate abilitate da Clea e sistemi industriali di nuova generazione, portando intelligenza in tempo reale, edge computing e machine learning all'interno delle operazioni industriali. Le soluzioni SMARC IQ8 e COM-HPC Mini IQ9 saranno disponibili entro il Q3 2026.

Modular Vision con Qualcomm Dragonwing QCS6490: Edge AI in tempo reale per l'automazione industriale

Una delle novità presso lo stand SECO sarà il **Modular Vision basato su Dragonwing QCS6490**, disponibile nelle versioni da 10,1" e 15,6" per la prossima generazione di automazione industriale. Progettato come HMI industriale compatta, combina in un unico dispositivo computer vision, elaborazione dei comandi vocali e interazione utente intuitiva per abilitare operazioni industriali più efficienti. L'integrazione con Clea fornisce una base sicura per la gestione dei dispositivi, aggiornamenti OTA e supporto lungo l'intero ciclo di vita.

La soluzione sarà presentata attraverso **un'esperienza dal vivo che mostrerà casi d'uso AI in tempo reale e indipendenti dal cloud, come gestione dell'impianto produttivo, gestione degli alert e controllo qualità basato su AI, tutti eseguiti localmente all'edge con latenza ultrabassa**. I preordini sono ora aperti e disponibili su [questa pagina](#), supportando una rapida transizione dalla fase di valutazione a quella di deployment.

Piattaforme SMARC scalabili e casi d'uso reali di Edge AI

Per rispondere a requisiti Edge AI a prestazioni superiori, SECO presenterà il proprio **portafoglio SMARC basato su Dragonwing QCS6490 e Qualcomm Dragonwing QCS5430**, intesi come building block flessibili ed efficienti per sistemi embedded e di AI industriale.

Un caso d'uso chiave presentato a embedded world è MUSAI, un sistema AI subacqueo modulare basato su [SOM-SMARC-QCS6490](#). MUSAI esegue computer vision e classificazione di oggetti in tempo reale all'edge, dimostrando inferenza AI affidabile su piattaforme SMARC basate su Dragonwing QCS6490 in ambienti con vincoli di potenza e connettività. Integrato con **Clea**, abilita la gestione sicura dei dati e la visualizzazione tramite dashboard dedicata, mostrando un'architettura edge-to-cloud pronta per la messa in produzione per monitoraggio scalabile e gestione della flotta.

Modular Link IQ-615: sistemi Edge intelligenti per Smart Grid e infrastrutture industriali

SECO presenterà inoltre [Modular Link IQ-615](#), un gateway industriale DIN-rail compatto per applicazioni smart grid e infrastrutture industriali, basato sulla serie **Qualcomm Dragonwing™ IQ-6 (IQ-615)**. Basato su CPU Qualcomm® Kryo™ 460 octa-core, supporta acquisizione dati, elaborazione locale e connettività sicura, integrando interfacce industriali chiave, storage eMMC, TPM 2.0 e SECO Clea OS (Linux Yocto). Progettato per ambienti gravosi, opera da -40°C a +80°C con consumo inferiore a 20 W e, integrato con Clea, abilita comunicazione sicura edge-to-cloud, gestione remota dei dispositivi e aggiornamenti OTA per soluzioni infrastrutturali industriali ed energetiche scalabili.

Abilitazione software e pipeline end-to-end per il deployment AI

Tutte le soluzioni basate su Dragonwing presentate da SECO sono supportate da uno stack software abilitante completo, progettato per accelerare l'adozione dell'AI all'edge. Attraverso l'[Application Hub](#) di SECO, i clienti possono accedere ad applicazioni AI e IoT pronte all'implementazione e ottimizzate per le piattaforme Dragonwing, mentre il SECO [Developer Center](#) fornisce accesso unificato a documentazione tecnica, BSP e risorse per lo sviluppo.

La pipeline end-to-end di deployment AI di SECO connette training del modello, deployment ed esecuzione all'edge in un unico workflow. Integrando **Edge Impulse** per il training e l'ottimizzazione dei modelli AI con il framework software **Clea** per un deployment sicuro e la gestione del ciclo di vita, SECO consente una transizione fluida dal proof of concept alla produzione. I modelli AI sono ottimizzati per le piattaforme Qualcomm® Dragonwing™ e vengono distribuiti in modo sicuro tramite Clea ed eseguiti localmente con inferenza a bassa latenza, mentre aggiornamenti, monitoraggio e gestione della flotta sono gestiti centralmente.

SECO e Qualcomm Technologies: guidare insieme il futuro dell'Edge AI

*"La nostra collaborazione con Qualcomm Technologies gioca un ruolo chiave nell'avanzamento dell'Edge AI in ambito industriale e smart", ha dichiarato **Davide Catani, Chief Technology & Innovation Officer di SECO**. "Combinando le piattaforme Dragonwing con l'expertise di SECO a livello di sistema e l'abilitazione software, offriamo soluzioni edge scalabili e ad alte prestazioni che aiutano i clienti a passare dall'innovazione al deployment più rapidamente e con fiducia."*



*"SECO si conferma apripista nel dimostrare come le piattaforme Dragonwing elevino prestazioni, efficienza e intelligenza all'edge industriale", ha dichiarato **Enrico Salvatori, Senior Vice President e President di Qualcomm Europe, Inc.** "Queste soluzioni forniscono una solida base tecnologica per accelerare l'innovazione industriale per HMI di nuova generazione, automazione di fabbrica, infrastrutture smart grid e altre applicazioni Edge AI. Non vediamo l'ora di vedere SECO presentare queste piattaforme a embedded world 2026."*

Inoltre, è prevista una sessione con relatore **Douglas Benitez, Senior Director, Business Development di Qualcomm Europe**, che si terrà l'11 marzo presso lo stand SECO. I visitatori sono invitati a partecipare allo **Stand 320, Hall 1**.

SECO

SECO (IOT.MI) è un'azienda high-tech che sviluppa e realizza soluzioni all'avanguardia per la digitalizzazione di prodotti e processi industriali. L'offerta hardware e software di SECO abilita le realtà B2B ad introdurre edge computing, Internet of Things, data analytics ed intelligenza artificiale nei propri business. La tecnologia di SECO si estende a numerosi campi di applicazione: sono oltre 450 i clienti serviti in settori come il Medicale, l'Automazione Industriale, il Fitness, il Vending, il Trasportation e molti altri. Consentendo di monitorare in modo accurato l'operatività dei dispositivi on-field, le soluzioni SECO contribuiscono alla nascita di modelli di business a minor impatto ambientale grazie ad un più efficiente utilizzo delle risorse.

Per maggiori informazioni: <http://www.seco.com/>

Contatti

SECO S.p.A.

Clarence Nahan

Head of Corporate Development & Investor Relations

Tel. +39 0575 26979

investor.relations@seco.com

